

JETRO

変化する通商環境と 台湾EMS産業の生産拠点配置およびサプラ イチェーン移転に関する調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）

調査部

2026年4月

目次

I. 台湾EMS産業を巡る通商環境の変化	3
II. 台湾EMS産業の生産拠点配置およびサプライチェーン移転	8
1. サーバー産業	8
2. ノートPC産業	17
3. スマートフォン産業	27
III. まとめ	35

■ 免責条項

本レポートは、日本台湾交流協会の協力を得て、財団法人資訊工業策進会産業情報研究所（MIC）に委託して作成しました（2026年1月時点）。本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

I. 台湾EMS産業を巡る通商環境の変化

1 | 米台間の関税交渉が妥結、 米国は232条に基づき特定の半導体への追加関税発動

米台間の通商合意の主な内容

- 2026年1月15日、米台間の相互関税（注）が正式に確定

20% **>** 15%

最恵国待遇（MFN）税率の累加なし。

- 台湾企業が米国で自主的に投資する金額は

2,500億ドル

対象は半導体、人工知能（AI）、エネルギーなどの関連産業。

- 台湾当局が信用保証を提供する金額は

2,500億ドル

企業およびサプライチェーンの対米融資獲得を支援。

1962年通商拡大法232条（以下、232条）に基づく半導体への追加関税発動状況と今後の見通し

1月14日追加関税賦課決定

- 米国に輸入される特定の半導体に対する25%の追加関税賦課決定
対象となる半導体（HSコードおよびその他要件）

8471.50
処理装置

8471.80
その他の装置

8473.30
自動データ
処理機械の
部分品

性能およびメモリ帯域幅が以下の基準を満たす場合は対象となるが、**米国内で自社利用する場合は免除。**

- 総処理性能（TPP）が14,000超17,500未満、かつ総DRAM帯域幅が4,500 GB/s超5,000 GB/s未満
- TPPが20,800超21,100未満、かつ総DRAM帯域幅が5,800 GB/s超かつ6,200 GB/s未満

- 米国の将来的な232条関税に関する米台合意の関連内容

台湾企業が半導体生産工場を
米国内で新設する場合（建設期間中）

予定生産能力の2.5倍までの輸入を免税、
割当超過分の輸入には、低率の232条関
税を適用。

新設した半導体工場の建設
プロジェクトが完了した企業

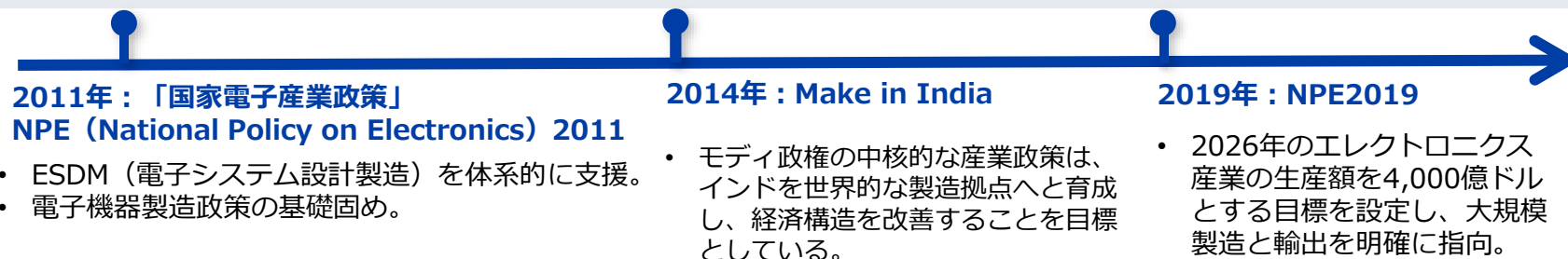
新規生産能力の1.5倍以内
の範囲で免税待遇。

今後の見通し

大統領布告では、今後90日間各国・地域と交渉を継続後、対象拡大する可能性および米国の半導体供給網構築に投資する企業に関税相殺制度を設ける可能性を示唆。

2 | インドにおける電子機器製造の産業政策

- インドは、エレクトロニクス産業を支援するための一連の政策を打ち出し「世界の電子機器製造の中心地」を目指す。



生産連動型奨励策（PLI）を中心とした製造奨励の枠組み

2020年 | 生産連動型奨励策（PLI）

- 5年間の「売上増分」に対して4~6%のインセンティブを提供。
- 大量生産を牽引して組立、テスト、マーキングおよびパッケージング（ATMP）への投資を誘致。

2021年 | ITハードウェアPLIスキーム

- ノートPC、タブレット、オールインワンPC、サーバーのインドでの生産シェアを拡大。

2021年 | 半導体・部品関連政策

- インド半導体ミッション（ISM）：半導体、ディスプレイウエーハ工場の設立を計画。
- 電子部品・半導体製造促進政策（SPECS）：電子機器製造業における工場設立のための投資を支援。

2023年 | PLI2.0

- 補助対象範囲をウルトラスマールフォームファクターデバイス（Ultra-small form factor devices、注）まで拡大し、電子部品製造に注力。

2026年 | 電子部品製造優遇スキーム（ECMS）

- 投資を誘致し、インド現地の電子部品エコシステムを改善。

一定割合の現地製造・部品調達を条件に インセンティブ付与

現地での製品組立を起点に、各種インセンティブ制度を通じて、部品や中間財の現地生産・現地調達を段階的に促進し、製品の現地付加価値向上を図る。

（注）超小型筐体のPCなどを指す。

（出所）Ministry of Electronics and Information Technology（MeitY）、MIC整理、2026年1月

3 | メキシコを巡る新たな動き

2026年1月にメキシコの新関税制度発効、同年7月にはUSMCAが見直しを迎える

メキシコの輸入関税率引き上げ

- 2025年9月9日、メキシコ政府は国内産業保護と輸入依存の是正を目的として、輸入品1,463品目について一般関税率の引き上げを柱とする関税法改正案を議会に提出（注）。同改正は2026年1月1日に発効。

重要な節目を迎える米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）

- USMCAは2026年7月に初の「共同審査」（Joint Review）を迎える重要な節目となる。メキシコを経由した中国製品などの迂回輸出への懸念が高まる中で、原産地規則の運用や通商ルールが見直される可能性が指摘される。同見直し次第で、ニアショアリングのメリットが一部企業・産業で低下する可能性も。

2024年における台湾の対メキシコ輸出

輸出額

79.06億ドル

台湾の総輸出の1.7%を占める。

輸出品目の構成比

76%

グラフィックカード、チップ、PC部品、液晶フラットパネルディスプレイなど。

24%

鉄鋼、機械、電気機械、プラスチック・ゴムなどの従来製品。

（注）WTO加盟国が関税および貿易に関する一般協定（GATT）のウルグアイラウンド交渉において、他のWTO加盟国に対して約束した上限税率である「譲許税率」の上限は36.2%。上限税率の範囲内であれば、各国政府の裁量に基づき、MFN税率を変更（引き上げ、または引き下げ）することが認められている。2024年におけるメキシコの単純平均MFN関税率は7.4%にとどまっていることから、WTOルール上は一般関税率を引き上げる余地が大きいと指摘されていた。

（出所）メキシコ政府官報や台湾財政部統計など、MIC整理、2026年1月

4 地政学リスクの高まりの中、東南アジア、インド、メキシコへの生産拠点移管が加速

- チャイナプラスワン（脱中国化）の推進および関税リスク回避に向け、東南アジア、インド、メキシコへの生産拠点の移管が加速。

東南アジア・インドがPCとスマホの生産移管先に

米国では、ノートPCなどについて「実質加工」基準に基づいて原産地を認定しており、主にSMT工程（注）の実施場所を原産地としてみなされる。米国から迂回輸出と判断されることを避けるため、台湾EMS・ODMは**SMT工程を中国以外の地域で行う方向に移行**。



ノートPC

2026年の東南アジアにおけるノートPC
生産能力のシェア（推計値）は

28.7%



スマートフォン

2026年末までに米国に輸出するiPhoneは
すべてインド生産となる見込み

（注）SMT（Surface Mount Technology）とは、プリント基板に電子部品を取り付ける表面実装技術の工程。

（出所）MIC、2026年1月

メキシコが米国市場へのサーバー部品の供給先に

台湾のサーバーOEMおよびブランド企業は、すでに米国（主にテキサス州、カリフォルニア州）に生産拠点を設立、または生産拠点の拡充を実施しており、かつ部品メーカーに対し現地拠点設立を継続的に働きかけている。

米国テキサス州のサーバー生産集積地に近いメキシコは、**米国へのサーバー部品（筐体、ケーブルなど）供給拠点**として存在感が高まっている。

EMS	メキシコでの主要生産プロジェクト
ホンハイ	AIサーバー、マザーボード実装、金属/プラスチック筐体部品（垂直統合型）、ノートPC、ネットワーク機器
ペガトロン	車載電子機器、サーバー
インベンテック	サーバー（L10最終組立/L11最終検査・テスト）、ノートPC（L6基板実装、L10）
ウイストロン/ ウィウィン	サーバー（マザーボード製造からラック組立まで）、車載電子機器
クアンタ	AIサーバー、車載電子機器
コンパル	サーバー（L10/L11）、車載電子機器（泰金宝の工場を賃借）

II. 台湾EMS産業の生産拠点配置 およびサプライチェーン移転

1. サーバー産業
2. ノートPC産業
3. スマートフォン産業

1-1 | サーバー：米国やメキシコでの組立拠点を展開

サーバー



産業への影響

- **232条に基づく追加関税の発動**：米国は特定の半導体に25%の関税を発動するとともに、今後の対象拡大の可能性を示唆。
- **計算能力競争の軸はシステムレベルへ移行**：計算能力を巡る競争は、単一GPUの性能比較から、複数のGPUを高速に相互接続したシステムレベルのプラットフォーム（AIインフラ）へと軸足が移っている。数千～数万規模のアクセラレーターを統合する大規模AIクラスターやスーパーコンピュータの構築段階に入っている。
- **ラック単位の消費電力・技術要件が高度化**：AIサーバー向けラック型プラットフォームの普及により、ラック単位の消費電力は100kW超に上昇。最先端構成では145kW規模に達し、電源供給・冷却技術が運用上のボトルネックになりつつある。
- **米国は国内生産を要求**：米国顧客はAIサーバーについて、**L10（単体サーバー組立）からL12（クラスター（AIポッド）構築）までを米国内で行うよう要求。**

対応策

- **米国とメキシコの2拠点体制による生産能力の移転**：米国でのサーバー製造は主に後工程の組立（L10/L11）が中心で、メキシコは北米市場向けのサーバー関連部品の供給拠点として存在感を高めている。
- **サプライチェーンの分散と台湾での研究開発継続**：**ハイエンドの研究開発および重要な製造工程を引き続き台湾で行い、部品生産を相対的に生産コストが安価なタイ、ベトナム、マレーシアなどに配置。**

1-2 | 2026年のサーバー需要は好調を維持

- AIトレーニングおよび推論向けで計算基盤の拡張が急速に進む中、テクノロジー大手および新興クラウド企業によるAIサーバー需要が拡大。**2026年の世界のサーバー市場は引き続き堅調な成長が見込まれている。**
- AI処理に伴う大量データストレージ需要が増加することで、AIサーバーだけでなく、一般サーバー市場の調達も拡大している。

世界のサーバー市場へ影響を与える要因

クラウドサービスプロバイダー

- 米州、アジア、中東のデータセンターを継続的に拡充。
- AIサーバー、インフラへの投資割合が増大。自社開発チップ、ラック型プラットフォームの調達量が増加。

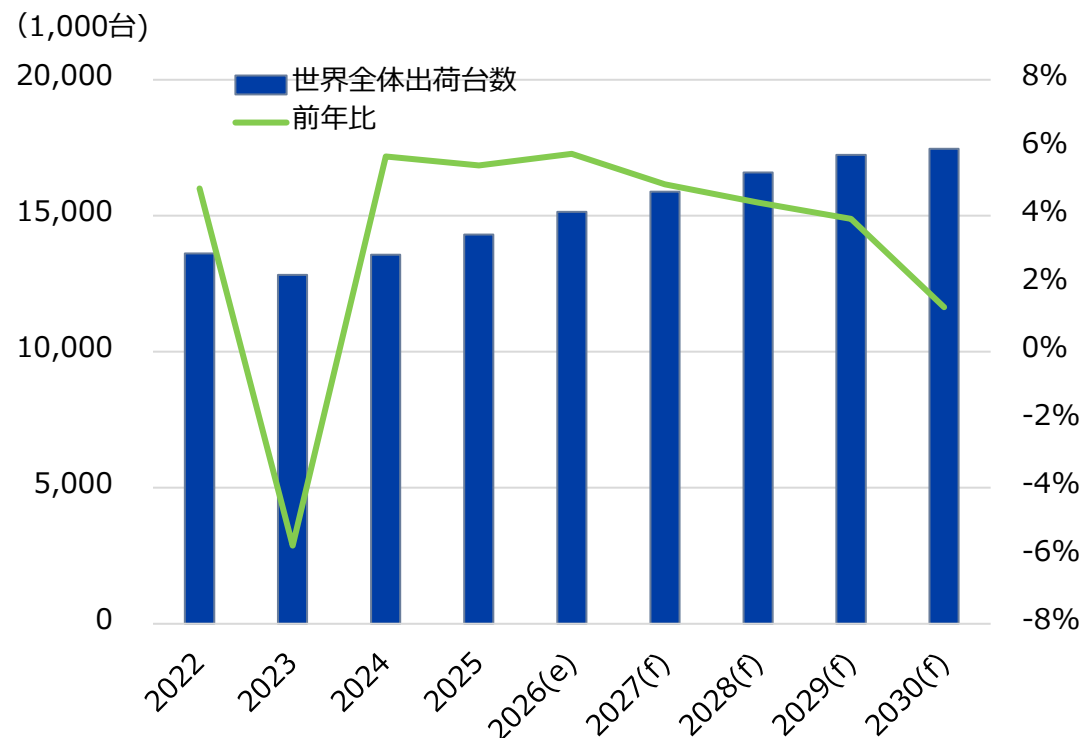
AI計算基盤プロバイダー

- 「ネオクラウド」と呼ばれるAIデータセンター事業者が台頭。
- ソブリンAIにより各国・地域独自の計算基盤が稼働し始めている。

サーバーブランド企業

- ネオクラウドへの供給、ソブリンAIによるデータセンター向けに供給。
- AIストレージの需要がCPUサーバーの調達を促進。

2026～2030年における世界のサーバー市場予測

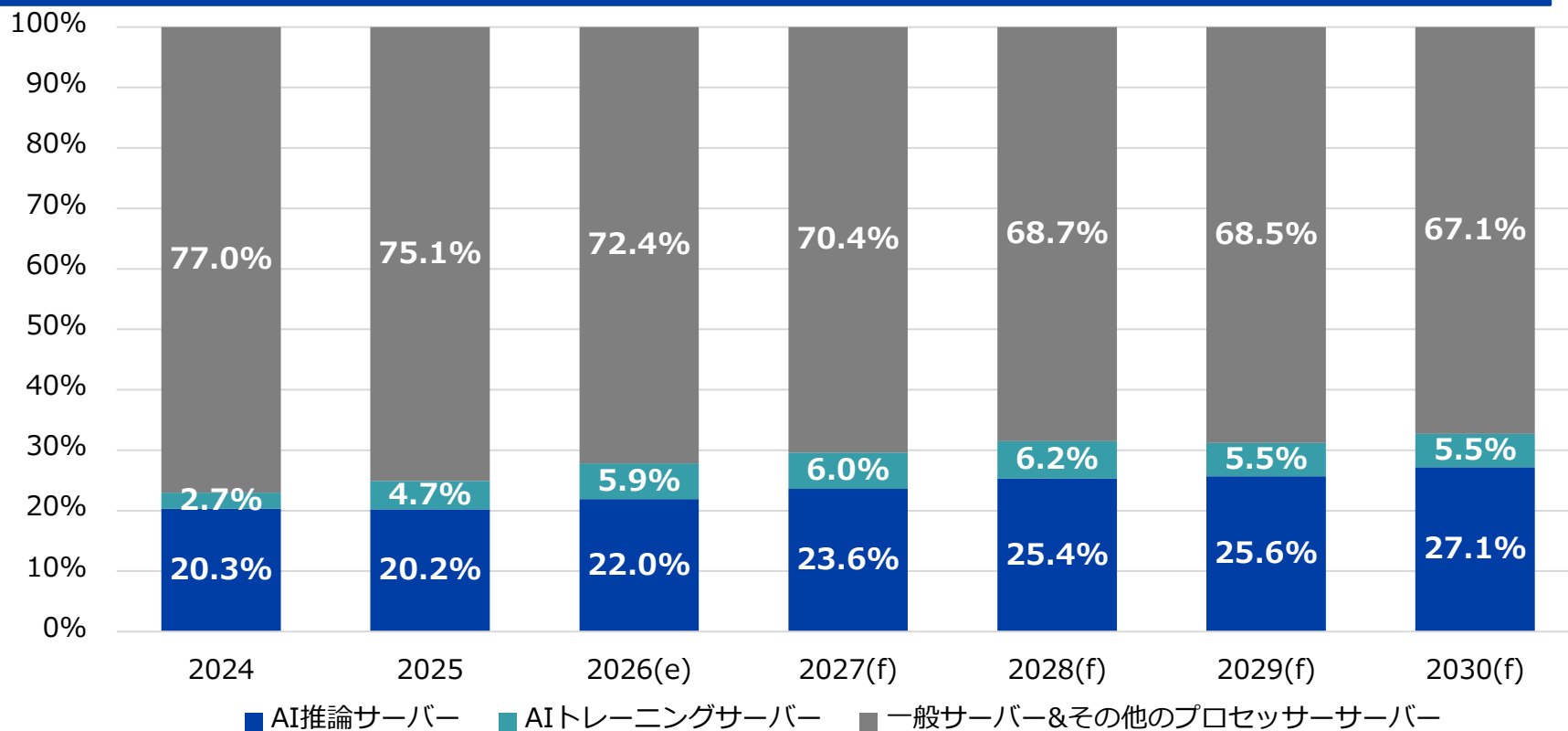


(出所) 各メディア、MIC整理、2026年1月

1-3 | 2027年にはAIサーバーの出荷割合が3割に

- サーバーの中で、AIサーバーの構成比が上昇しており、**2027年には約3割に達すると見込まれる。**
- クラウドサービスプロバイダーが自社開発のAIチップおよびシステムの展開を加速させる中で、今後AI推論サーバーの割合は徐々に高まる見通し。

2024～2030年における世界のサーバー割合予測

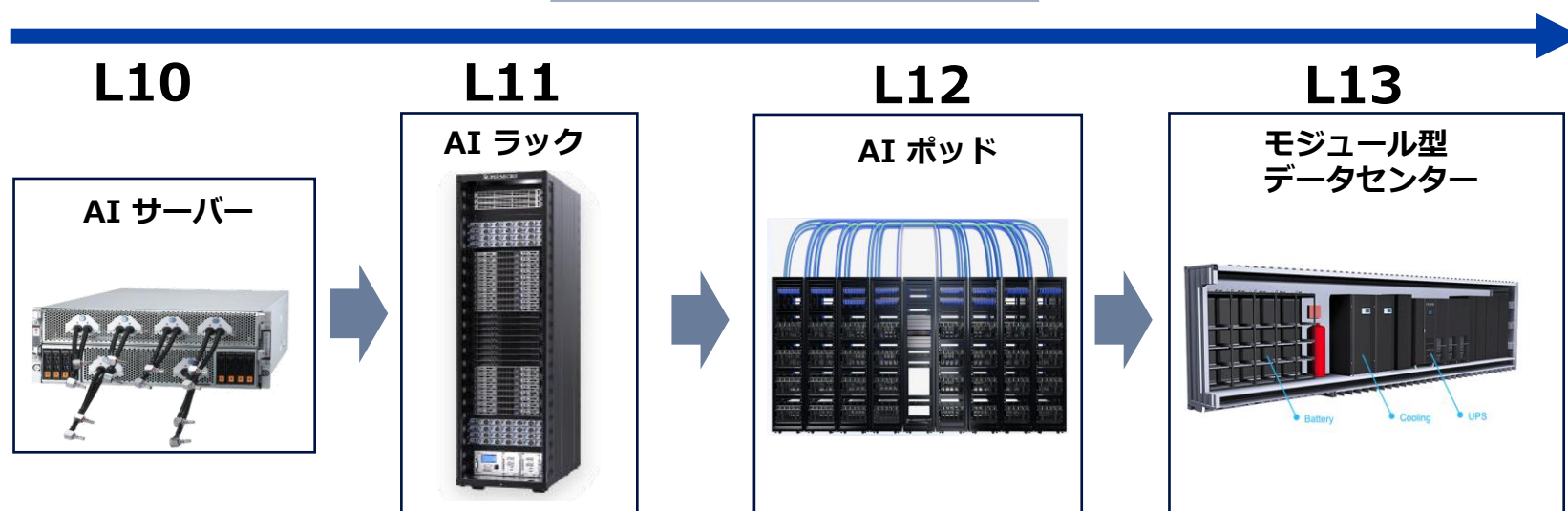


(注) 数値は四捨五入しているため、合計が必ずしも100%とはならない。
(出所) MIC、2026年1月

1-4 | 計算能力競争の軸はGPU単体からシステムレベルへ移行

- AI需要の急拡大に伴い、企業はサーバー単体ではなくラック単位やモジュール型で調達する動きを強めている。こうした中で、**単一GPUの性能向上だけではなく、複数GPUやネットワークを含むシステム全体を最適化することで、AIの計算能力を高める方向へとシフトしている。**

サーバー製造プロセス



- システム全体で処理性能のボトルネックを解決

単一GPUの性能向上が頭打ちになる中、**システム全体の最適化によってAIの計算能力を向上させる。**

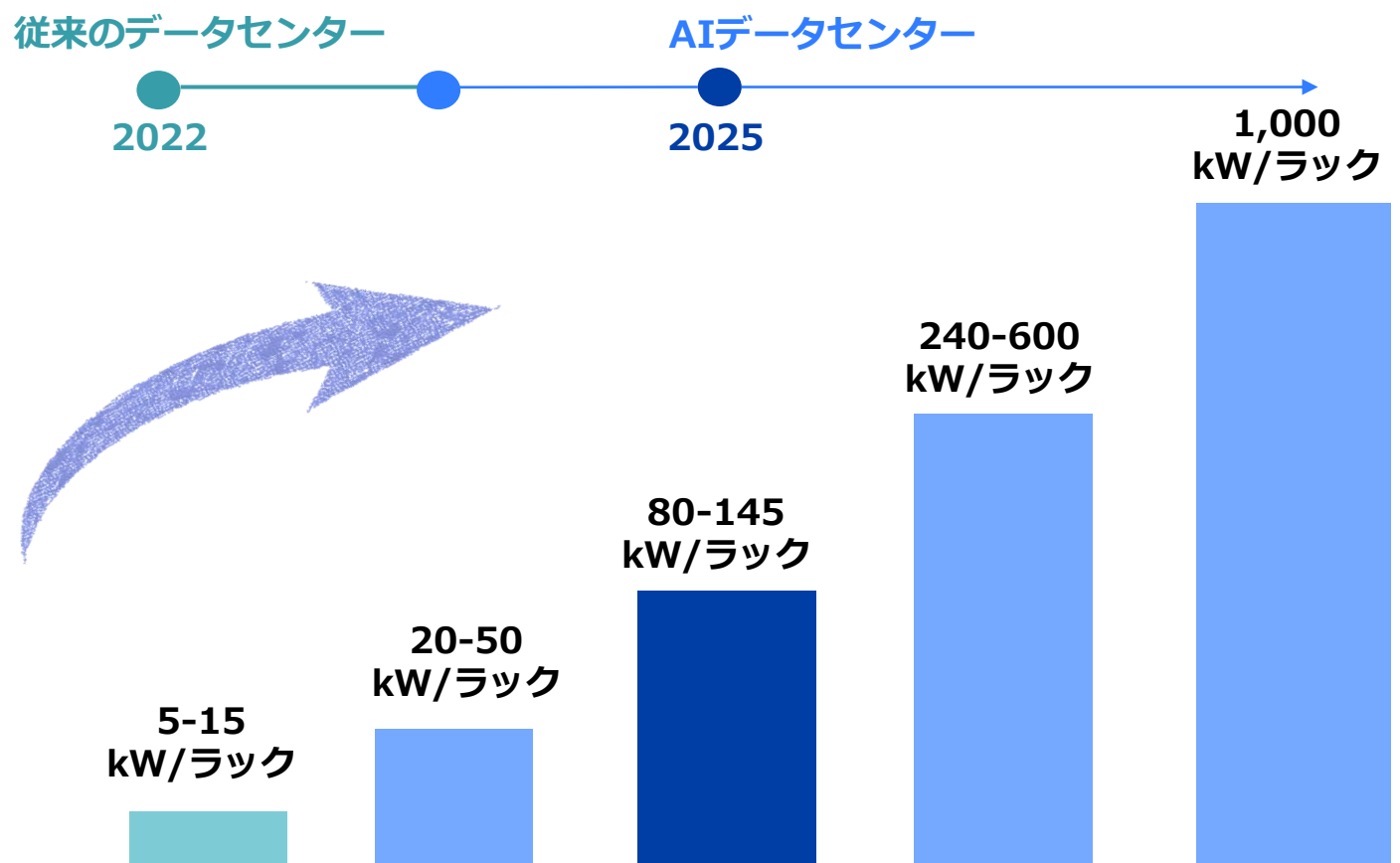
- システムレベルの計算能力競争が産業トレンドに

AI計算能力を巡る競争はすでに、単一GPUの性能やTDP（Thermal Design Power：熱設計電力）といった個別指標から、複数のGPUやアクセラレーターを相互接続し、統合したスーパーコンピュータを構成する「システム級プラットフォーム（AIインフラ）」へとシフト。

1-5 | ラック単位の消費電力は増加の一途

- クラウドベンダーなどによるラック型システムプラットフォームの展開が加速しており、**ラック単位の消費電力は増加傾向にある**。2025年には1ラックあたりの消費電力が80～145kW程度に上昇。

データセンター内の1ラックあたりの電力消費量の推移



1-6 | 台湾サーバーEMSのグローバル展開

- ハイエンドな研究開発と重要な製造工程は台湾に残し、部品生産などはコストの低い東南アジア地域に配置している。
- 米国では、主にサーバーの後工程製造（L10/L11）を担い、対米投資の要件に対応している。メキシコは北米市場向けのサーバー関連部品の供給拠点として存在感を高めている。

台湾サーバーEMSの拠点拡大戦略

1. 拠点戦略：顧客ニーズを最優先
2. 拡張手法：短期的にはリース、長期的には投資による工場建設
3. 生産配置：市場需要に応じて、生産拠点を最適に配置
4. コスト戦略：筐体・機構部品メーカーは生産コストの低い地域へ拠点を配置

米国

- EMS：L10/L11ラック組立
 - ✓ テキサス州：ホンハイ、インベンテック(ケイティ)、ウィストロン(ダラス・フォートワース)、ウィウィン、コンパル、ペガトロン(ジョージタウン)
 - ✓ カリフォルニア州：クアンタ、ウィストロン、技鋼、マイタック(フリーモント)
 - ✓ テネシー州：クアンタ
 - ✓ ウィスコンシン州：ホンハイ
 - ✓ オハイオ州：ホンハイ
- 部品メーカー：
 - ✓ テキサス州：DELTA(プレイノ)、ライトン(ダラス、プレイノ)、チェンブロマイコム(ダラス)、キングスライド(ヒューストン)

- ↑
- サーバー組立
- 部品生産

メキシコ

- EMS：ホンハイ、クアンタ、インベンテック、ウィストロン
- 部品メーカー：ライトン、ビズリンク

東欧

- EMS：ホンハイ、ウィストロン、インベンテック

台湾

- ハイエンドサーバーの受託製造および部品メーカーの研究開発と重要な製造拠点
- GPU基板
- サーバー組立

タイ

- EMS：クアンタ
- 部品メーカー：Auras、ライトン、Chenming、ユニマイクロン、Gold Circuit Electronics

マレーシア

- EMS：ウィウィン、ギガバイト
- 部品メーカー：チェンブロマイコム、InWin

東南アジア、ヨーロッパ市場に供給

ベトナム

- EMS：ホンハイ、マイタック
- 部品メーカー：Asia Vital Components、ライトン、クーラーマスター、REPON、Accton

主にサーバー部品、機械部品、冷却、電源など

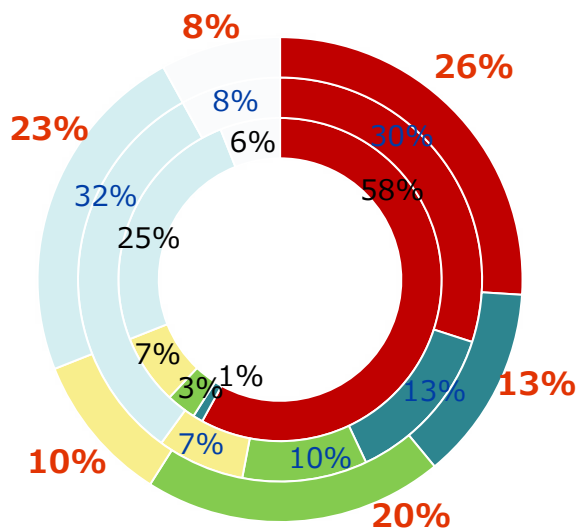
赤字で示した企業は新工場が2026年に稼働開始
緑字で示した企業は新工場が2027年に稼働開始

1-7 | 台湾サーバーEMSの海外生産拠点配置の方向性

- サーバーはPCやスマートフォンに比べて**利益率が高く、対米投資の要請に応じやすい**。特に**AIサーバーでは、需要拡大に加え「ソブリンAI」重視**の流れを背景に、**経済安全保障上の観点から米国内設置を求める動きが強まっている**。メキシコでも増産は進む一方、**米国内のL10/L11工程の拡張がより速い**。液冷ラック需要の高まりや顧客近接の利点から、**高付加価値AIサーバーは米国内に集約**され、結果として**メキシコの生産比率は相対的に低下**している

台湾サーバー産業の生産拠点割合の変化

一般サーバー

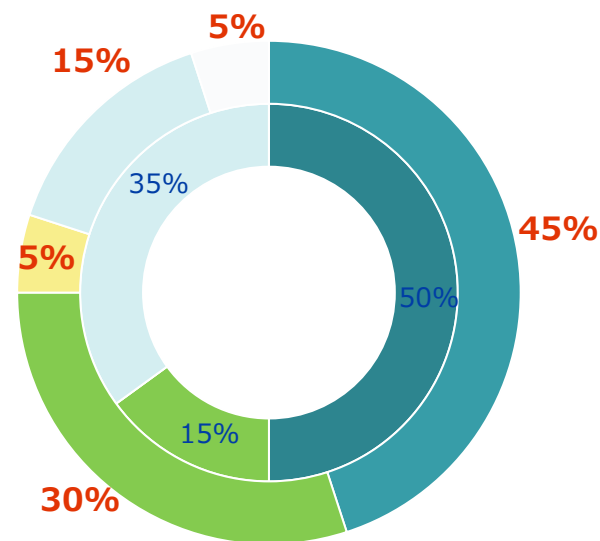


■ 中国 ■ 台湾 ■ 米国 ■ 東南アジア ■ メキシコ ■ 欧州

(注) 内側円から外側円へ：2019年、2025年、2029年 (予測)

(出所) MIC、2025年12月

AIサーバー



■ 台湾 ■ 米国 ■ 東南アジア ■ メキシコ ■ 欧州

(注) 内側円から外側円へ：2025年、2029年 (予測)

1-8 | 日台協力の可能性、ホンハイと三菱電機の事例

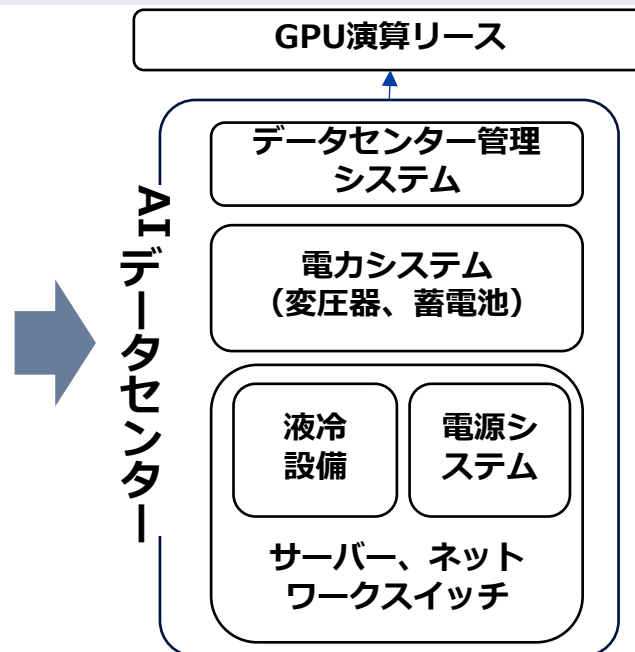
- 台湾はハードウェアやソフトウェア関連などに強みを持ち、日本は熱管理や電源関連装置などで優位性を持つ。
- 日本企業と台湾企業によるAIデータセンター関連の協業事例もある。

台湾

- ハードウェア：ギガバイト（サーバー設備）、ケンテック（熱管理）、アクベル（電源システム）、KAORI Heat Treatment（熱管理）、アルファネットワークス（ネットワーク機器）
- ソフトウェア：INFINITIX（GPU演算スタック）およびAGARUDA SYSTEM（データセンター管理プラットフォーム）

日本

- AIサーバーの半導体川上材料（PCBキャリアボード、電源IC、放熱材、シリコンフォトニクスなど）
- 熱管理設備
- 電気機械システム、蓄電池など



三菱電機とホンハイが共同で、AIデータセンター向けソリューションをグローバルで供給

- 2025年11月に三菱電機とホンハイは高効率で高度な信頼性を備えたAIデータセンター向けソリューションをグローバルで供給することを目的とした、協業に関する覚書を締結。
- 将来的には、持続可能性などの社会的課題に取り組む過程で、両社のノウハウを相互活用することで、AIデータセンター領域以外においても新たな価値、ソリューション、ビジネスモデルを共同で創出することを目指すとしている。

II. 台湾EMS産業の生産拠点配置 およびサプライチェーン移転

1. サーバー産業
2. ノートPC産業
3. スマートフォン産業

2-1 | ノートPC：サプライチェーンの強靱化に向け 生産拠点を多元化

ノートPC



産業への影響

- **232条に基づく半導体追加関税発動**：米国は特定の半導体に25%の関税を発動するとともに、今後の対象拡大の可能性を示唆。
- **部品コストの高騰**：メモリおよびストレージデバイスの供給不足により、PCの製造コストが大幅に上昇。一部モデルで値上がり幅が16～30%に達するとの見通しも。
- **「2つのシステム」の形成**：米国市場に輸出されるノートPCブランドは「チャイナプラスワン」を加速。一方で、**中国市場向けでは国産化と白牌（ホワイトボックス、ノーブランド）のノートPCを中心として中国独自の生産エコシステム（China Technology Ecosystem：CTE）の活用が台頭**。米国系ブランドとの間で「1つの世界、2つのシステム」という競争構図が鮮明になっている。

対応策

- **販売価格・仕様の調整**：ブランド各社はさまざまなプロセッサおよびメモリ仕様を組み合わせた幅広い価格帯のモデルを提供するとともに、一部モデルで値上げを実施。
- **生産能力の移転加速**：「チャイナプラスワン」戦略をさらに進め、ノートPC生産能力をベトナムやタイといった労働力に優位性のある地域にシフト。
- **インドの政策補助の活用**：ブランドメーカーおよびEMSは、インドのPLI2.0の奨励策およびECMS政策を活用しながら現地生産を拡大。インド政府が求める現地付加価値（Local Value Addition）の引き上げ要請への対応を図っている。
- **CTEの活用による市場シェア拡大**：**中国の生産エコシステム（CTE）を活用し、中国または新興国市場への展開を進める動きがみられる。**

2-2 | 台湾EMSによる生産拠点の再配置が継続

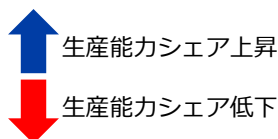
- ノートPCの生産拠点は、中国から東南アジアへの移管が継続。相対的に安価な人件費、徐々に成熟しつつある電子産業の基盤、大規模な量産に対応できる柔軟性などが背景に。

年	インド	中国	東南アジア	台湾	中南米
2026(e)	0.2%	67.4%	28.7%	1.7%	1.7%
2029(f)	4.2%	50.9%	40.9%	1.8%	2.1%

メキシコ

シウダー・ファレス

ホンハイ、インベンテック



ブラジル

マナウス サンパウロ コンパル
サンパウロ ホンハイ

中国

成都市 重慶市 武漢市 深セン市



クアンタ、コンパル、ウイストロン、
インベンテック、ペガトロン、ホンハイ

インド

バンガロール ウイストロン
ノイダ インベンテック



タイ

チョンブリ県 クアンタ
サムットプラカーン県 インベンテック



ベトナム

ハナム省 ウイストロン
ハイフォン市 ペガトロン
ナムディン省 クアンタ



台湾

桃園 新北 新竹
クアンタ、コンパル、
ウイストロン、インベン
テック、ホンハイ
バクニン省 ホンハイ
タイビン省 コンパル
ヴィンフック省

2-3 | ベトナム北部とタイ東部に集積

- 台湾EMS各社の生産拠点は、ベトナムでは中国から部品を陸送で効率的に調達しやすい北部沿海地域に集中している。
- タイでは首都バンコクに近く、政府資源や人材確保の面で優位性が高い東部地域に集積している。

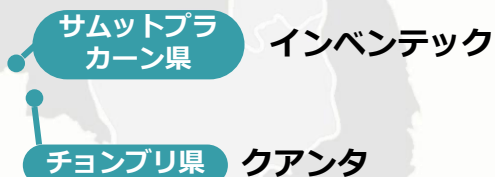
ベトナム北部沿海地域に集中

十分な労働人口を有するとともに中国に接するため、陸送による効率的な部品調達が可能。また、沿海のため海運での出荷にも利便性が高い



タイ東部に集中

首都バンコクに近く、政府資源および人材獲得の面で優位性が高い。地理的に沿海地域に位置するためアジア市場およびグローバル市場への輸出にも利便性が高い



2-4 | インドは「非中国・非米国」サプライチェーンの新たな生産・供給拠点構築の兆し

- インドは人口規模を背景とする内需のポテンシャルや、PLIに代表される政策インセンティブを受け、ノートPCの「チャイナプラスワン」サプライチェーンにおける新たな生産・供給拠点へと徐々に成長。

ウットル・プラデッシュ州

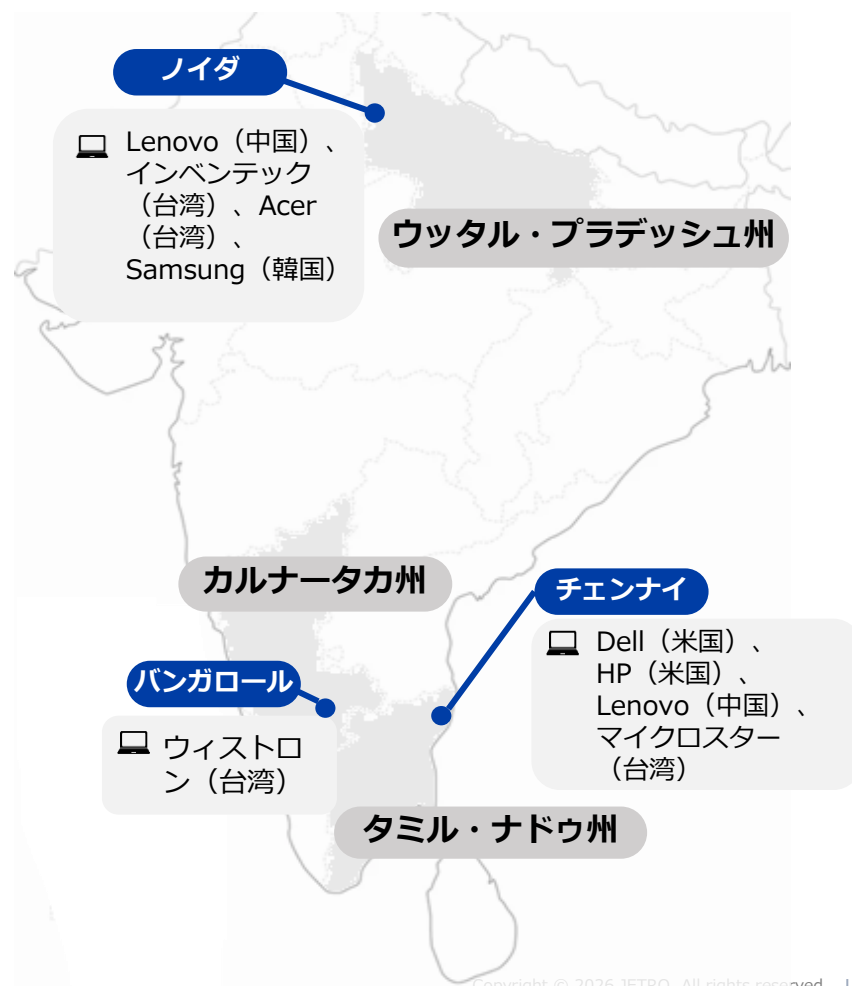
- 2021年からAcerおよびDixonがノイダでノートPCを量産。
- 2023年にDixonがLenovoとの契約を獲得し2024年5月から生産開始。
- 2024年にSamsungがノイダの携帯電話工場のノートPC生産ラインを増設。
- 2025年10月にインベンテックとDixonが合併会社を設立。

カルナータカ州

- 2024年にウィストロンが約150億ルピーを投資し、インドのエンジニアリングビルダーShapoorji Pallonjiとの間で契約を締結、バンガロールにノートPC製造工場を設立し、2026年に生産を開始する計画。

タミル・ナドゥ州

- 2024年にDixonの完全子会社Padget ElectronicsとHPは協力覚書（MOU）を締結、ノートPC、デスクトップPCおよびオールインワンPCの生産を支援。
- 2021年にLenovoがポンディシェリに第3のノートPC生産ラインを増設。
- 2025年1月にマイクロスターとSyrma SGS Technologyが提携し、チェンナイでノートPCを生産。

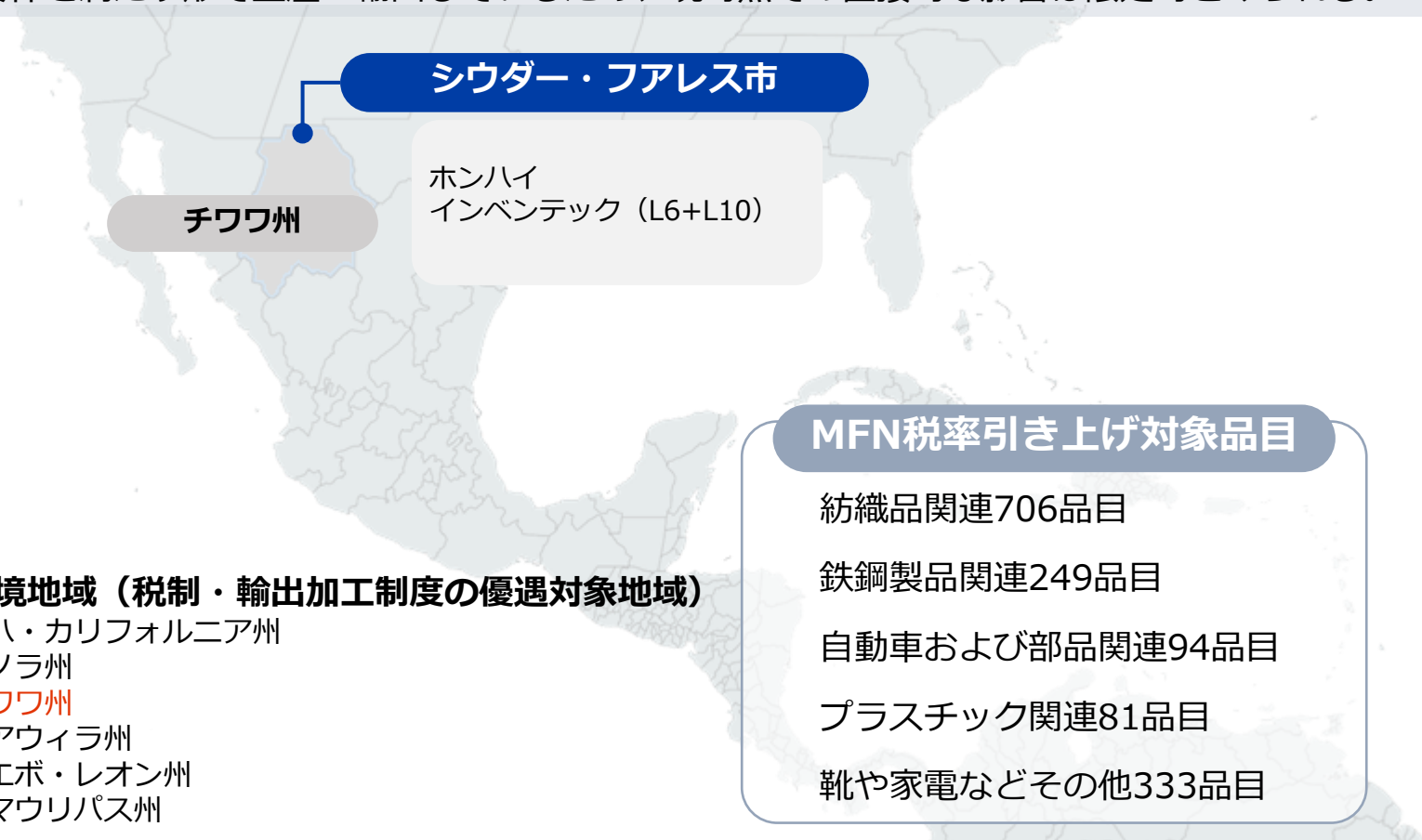


2-5 | 台湾EMS、東南アジアとインドでの生産能力拡大を継続

地域	EMS	ノートPCの生産拠点配置に関する動向（2025年以降）
ベトナム	ウイストロン	・ 2025Q1、VictoryIIの稼働を開始、年間587万台のノートPCを生産できる体制を整える。
	コンパル	・ 2025年Q1、海外工場設立および台湾拠点拡充を目的とし、2025年の資本的支出を2024年比で30億台湾元増の100億台湾元とする計画を発表。
	クアンタ	・ ベトナムナムディン省ミチュン工業団地のノートPCの生産能力を、2024年の130万台から、2025年に260万台、2026年に360万台、2027年に400万台、2028年に450万台に引き上げる計画（2024年Q4時点）。
	ペガトロン	・ 2025年Q1、子会社Pegatron Vietnamが、約15億7,800万台湾元を投じ、借地委託建設による工場設立を発表。
タイ	クアンタ	・ 2025年Q4、生産能力の拡大を目的とし、タイ子会社QMBが工場建設プロジェクトの発注を発表。総額9億台湾元を投入予定。
	インベンテック	・ 2025年Q1、タイのリース工場で量産開始。 ・ 2025年Q4、子会社Inventec Electronics (Thailand) がサムットプラカーン県のBhakasa Industrial工業団地に土地を購入することを計画。生産設備および工場建設の総投資額は1億2,500億ドル。 ・ 2026年Q1、同子会社が約43億台湾元の投資を発表。タイ国内の自社所有地に新工場を建設し、工場改修および設備購入を進め、ノートPCおよびサーバーの生産能力を拡大する計画。
メキシコ	インベンテック	・ 2025年Q2、メキシコ工場では既存のSMTライン6本および車載向け生産ライン4本に加え、新たにノートPC組立ラインの増設する計画が進められている。
	コンパル	・ 2025年Q3、北米のサーバー業務に3億ドルを投資し、米国とメキシコに L10、L11工場を設置。2026年上半期に量産を開始し、少数の生産ラインを車載用電子部品とノートPC用とする予定。
インド	ウイストロン	・ 2024年Q4、既存拠点の付近にノートPCの生産ラインを設置、2026年1月の生産開始を予定。 ・ 2025年Q2、子会社がShapoorji Pallonji And Companyと総額2,898万ドルの土木建築請負契約を締結したと説明。
	インベンテック	・ 2025年Q4、インドの大手電子機器メーカーDixon Technologiesと合併会社Dixon IT Devicesを設立。インドのITハードウェア市場に共同で参入し、ノートPC、サーバー、デスクトップPCおよび電子部品の現地生産を推進。
	ホンハイ	・ インドHCLTechnologiesと共同で建設したチップ工場において、2027年にノートPCやスマートフォンなど向けのチップを生産する計画。

2-6 | メキシコの関税引き上げの影響は現時点では限定的

- メキシコは自由貿易協定（FTA）の特恵税率が適用されない輸入品を対象に、合計1,463品目（注）の一般関税率（MFN）の引き上げを実施。一方、ICT製品の完成品（PC、サーバーなど）は今回の対象品目に含まれず、また台湾EMS・ODM各社はメキシコ北部国境地域（税制・輸出加工制度の優遇地域）に多く進出し、USMCAの原産地要件を満たす形で生産・輸出しているため、現時点での直接的な影響は限定的とみられる。



（注）メキシコのHSコード8桁ベース

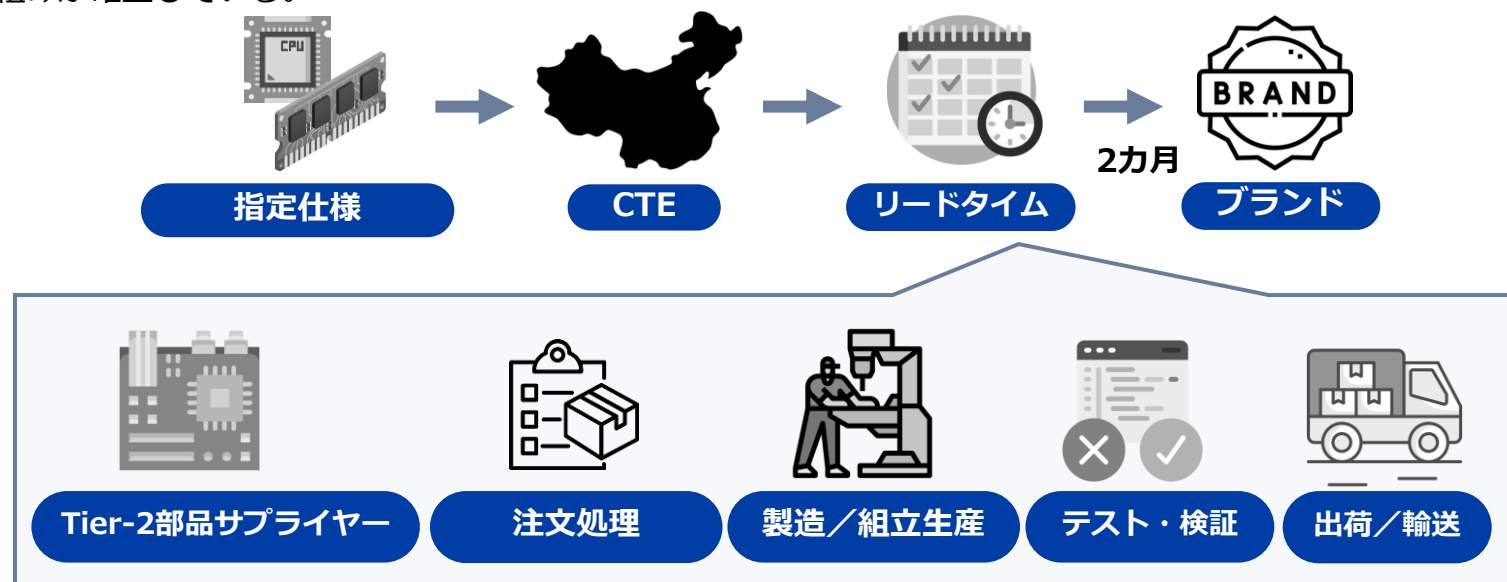
（出所）メキシコ連邦官報DiarioOficialde laFederación、MIC整理、2026年1月

2-7 | 中国のノートPC生産エコシステムの台頭

- 米中間の貿易摩擦および技術覇権争いの中、中国では国産化およびサプライチェーンの内製化が進展。従来から成熟していた白牌（ホワイトボックス、注）を中心としたノートPCの生産エコシステムは、生産コストと地政学リスクを調整・吸収する重要な手段としての役割を高めている。
- 米国市場に輸出されるノートPCブランドは「チャイナプラスワン」を加速する一方で、**中国市場や新興国市場向けでは、台湾ブランドのみならず一部米国ブランドもCTEの活用を進めている。**

China Technology Ecosystem (CTE)

- **高度に現地化されたサプライチェーン**：チップ、モジュール、筐体部品、完成品の製造までが中国国内に集積。
- **スケールメリットおよび迅速なカスタマイズ対応**：SKUの調整が迅速、仕様の柔軟性が高く、製品の市場投入までのリードタイムが短い。
- **コスト競争力**：米国系、台湾系ブランドに比較し高い価格競争力を有する。
- **OEMおよび共有プラットフォームのモデルが成熟**：ブランドの研究開発や設備投資のハードルを低減できる仕組みが確立している。



(注) ノーブランドや無名ブランドを指す。

(出所) MIC、2026年1月

2-8 | メモリの価格高騰を受けPCの値上げが相次ぐ

- 業界の現状：メモリとストレージの不足および見積価格の高騰のため、PCメモリのコストが上昇。大手PCブランドは2025年末から2026年初頭に販売価格の値上げを相次いで発表。**値上がり幅は最大30%に達する可能性も。**

チップ設計企業の対応（クアルコム、AMD）

Qualcomm

- プラットフォームの高い柔軟性を確保し、メーカー、容量、動作速度の異なる複数のメモリ構成に対応することで、OEMやODMに部材を柔軟に選定できる設計に

AMD

- DDR4メモリ（注1）対応のAM4プロセッサ（注2）を求める一部ユーザーの需要を踏まえ、一部のAM4プロセッサの生産再開を検討

ブランド企業は多様な価格帯の選択肢を提供（HP）

- HPの「OMEN 15」の主流機種では、IntelとAMD合わせて15種類のプロセッサから選択できるよう提供。メモリは8GB-32GBの選択肢を用意。

（注1）DDR（Double Data Rate）方式の第4世代メインメモリ規格。成熟規格でコスト競争力が高いとされる。

（注2）AMDの旧世代CPUプラットフォーム。DDR4対応。

（出所）各メディア、MIC整理、2026年1月

希望小売価格の変化（DELL）

DELL	2024年		2026年	
	XPS14	XPS16	XPS14	XPS16
モデル				
プロセッサ	CoreUltra7155H		CoreUltra5325H	
メモリ	16GB			
SSD	512GB			
最低販売価格（ドル）	1,699	1,899	2,050	2,200

値上がり幅
16%~20%

- Dell XPS（ビジネス向けノートPC）シリーズの最低販売価格は2024年比で16%~20%の大幅上昇。
- 多くのノートPCは2026年初頭に希望小売価格が発表されず、発売間近になってから発表。

2-9 | 日台協力の可能性、ソフトウェアとハードウェアの統合

- 日本企業は材料などで優位性を有し、サプライチェーンの安定性や安全性といった課題への関心が非常に高いとされる。一方、台湾企業は、システム統合や製品化に優位性を持つ。双方の強みを活かし、ハイエンドAI PCエコシステムを共同構築できる可能性があると考えられる。

日本：コア技術と部材に強み

重要なハードウェアおよび材料

- ・ 信頼性の高い放熱材、電池、精密機構部品など
- ・ センサー、映像関連部品、産業用部品など

ソフトウェア・システムのノウハウ

- ・ デバイスドライバ、システム安定性など
- ・ 長期ライフサイクルの製品設計（商用／産業用／政府機関向け）

信頼性の高いサプライチェーン

- ・ コンプライアンス遵守、情報セキュリティおよび高い品質面の信頼性

台湾：システム統合と量産に強み

AI PCの統合的なシステム設計能力

- ・ SoC/NPU統合、消費電力の最適化、モジュール化設計

ハードとソフトの協調開発実績

- ・ OS、ドライバー、AI フレームワーク、アプリケーションのプリロード対応

グローバルな製造・供給の柔軟性

- ・ 市場ニーズに応じた生産地で量産が可能

ブランドとプラットフォームとの連携能力

- ・ インテル、AMD、クアルコム、マイクロソフトのエコシステムに精通

ハイエンドAI PCエコシステムの共同構築の可能性

II. 台湾EMS産業の生産拠点配置 およびサプライチェーン移転

1. サーバー産業
2. ノートPC産業
3. スマートフォン産業

3-1 | スマートフォン：生産拠点の再配置が加速

スマートフォン



産業への影響

- 生産能力のさらなる調整が急務**：スマートフォンの組立工程の生産能力は、**依然として約6割が中国に集中する**。米国の第2次トランプ政権では、米国内での製造を強調するとともに、海外からの輸入製品に対する相互関税、232条に基づく特定の半導体に対する追加関税措置などの貿易措置が発動される中、台湾企業は中国からの生産拠点の移転の加速と他国・地域への生産能力の再配置を急速に進めている。
- 部品メモリなどのコスト上昇**：昨今のメモリ市場では需給のひっ迫を背景に価格の上昇が続いている。2026年には本格的な値上げ局面に入るとの見方が強まる中、スマートフォンブランド各社はコスト上昇圧力に直面するとみられる。

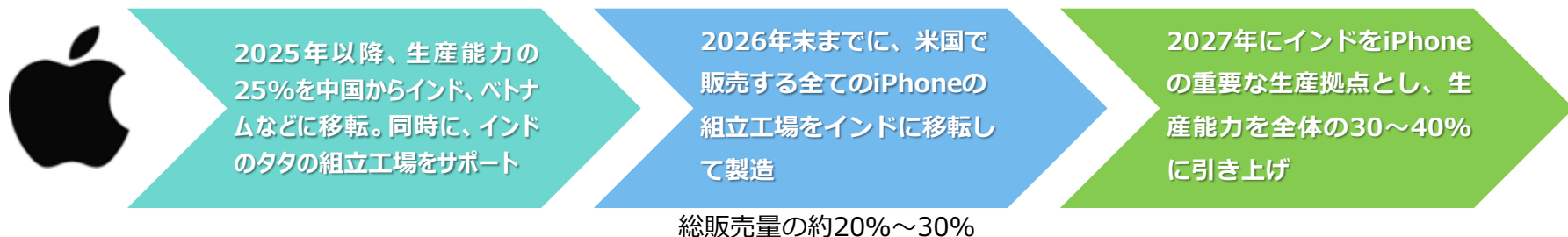
対応策

- 対米投資の加速**：米国による追加関税の適用除外・減免措置を獲得すべく、**台湾企業はAIサーバーなどの分野で対米投資を拡大**し、米国での製造を強化している。
- 生産能力の中国からの移転加速**：主なブランド企業（顧客）の目標にあわせ、台湾企業は中国から生産能力の移転を加速。関税による影響などを低減し、リスク分散を進めている。うち、**インドではAppleが生産能力を全体の25%まで引き上げる**方針を打ち出しているほか、現地での**チップの組立および封止を行うことについて検討を開始**。
- スマートフォンの仕様調整・販売価格の引き上げ**：スマートフォンブランド各社はメモリ価格の高騰に直面しており、その対応として、2026年にはスマートフォン向けメモリの仕様の引き下げと販売価格の上昇が生じる可能性がある。特に、ミドルエンドのスマートフォンにおいて、その影響が相対的に大きいとみられる。

3-2 | ブランド企業（Apple）のサプライチェーン移転戦略

戦略1：ODMに対して中国以外の国・地域への移転を要求、インドを中国に次ぐスマートフォン生産地に

- Appleの目標**
- 2025年以降、米国国内生産のためのサプライチェーンとインフラを確立し、対象部品の調達安定性を確保。
 - 2026年末までに米国で販売するiPhone（5,300~6,000万台）の組立拠点をインドに移転。



戦略2：米国関税措置への対応として、米国内のサプライチェーンを拡大し、中核部品の管理能力を強化

台湾サプライヤーの動向



合計**1,650億ドル**の投資を行い、アリゾナ州に**6つのチップ生産工場**、**2つのパッケージング施設**、**研究開発拠点を建設**。

米国子会社（GWA）がAppleと提携。テキサス州シャーマン市のGWAの新旗艦工場で**12インチの先端シリコンウエハー生産を共同で推進**。

米国系サプライヤーの動向



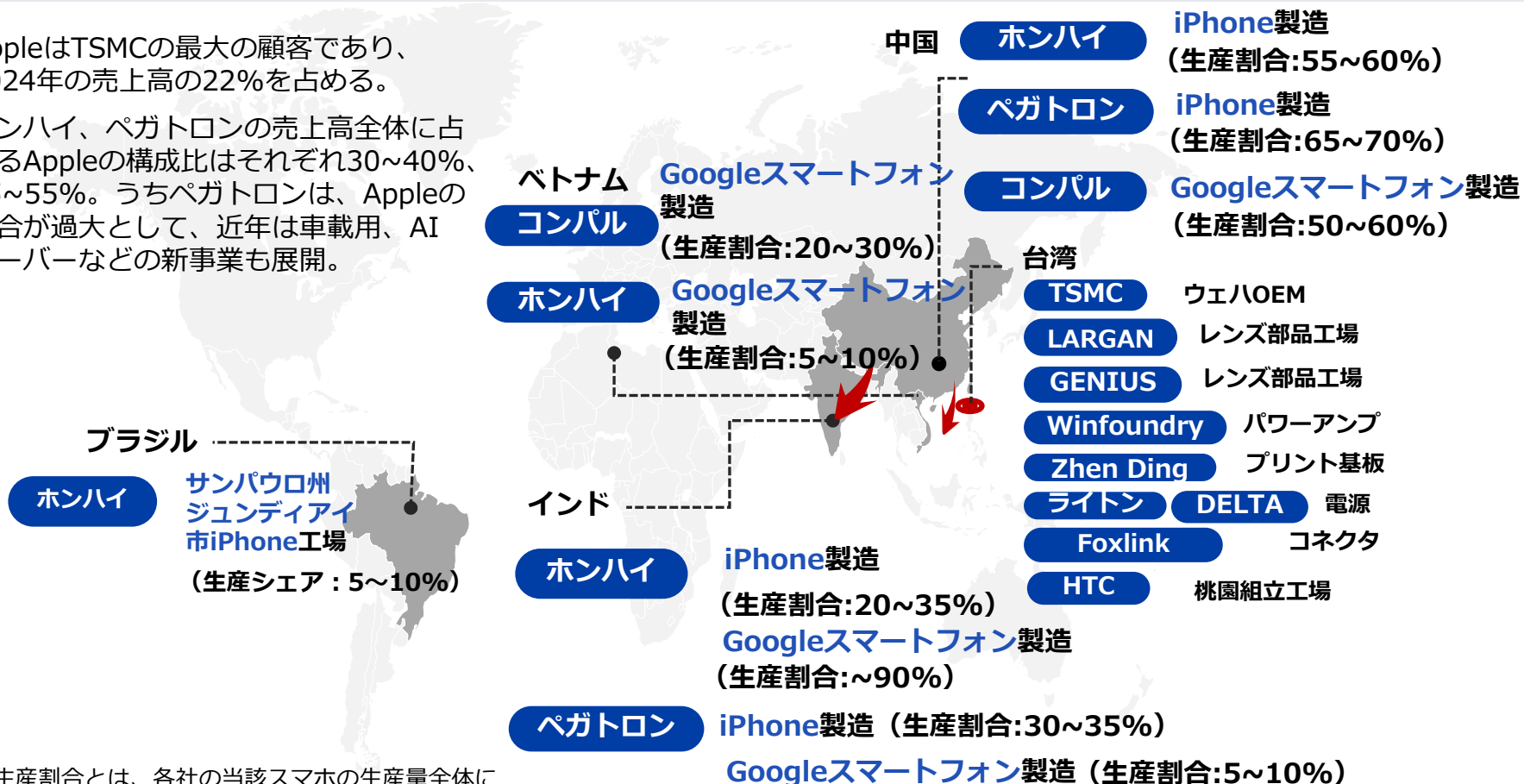
ケンタッキー州の工場ですべてのiPhoneとApple Watchの**ガラス筐体を生産**。Appleは**25億ドルの資金支援を承諾**し、生産ラインの人員を**50%増員**する計画。

アプライド・マテリアルズは**2億ドル**を投じて、アリゾナ州に**チップ設備工場を建設**。テキサス・インスツルメンツがApple向けチップの一部生産を担い、米国内の製造能力を強化。

3-3 | スマートフォンデバイスの生産状況

- 2024年、Appleは初めてハイエンドのiPhone 16 ProおよびPro Maxの製造の一部をインドに移転。
- 2025年、iPhone17シリーズの全製品がインドで生産可能に。標準版iPhoneの歩留まりは中国よりわずかに低い程度とされる。
- 2026年、Appleは**インドでのチップの組立および封止を行うことについて検討を開始。**

- ✓ AppleはTSMCの最大の顧客であり、2024年の売上高の22%を占める。
- ✓ ホンハイ、ペガトロンの売上高全体に占めるAppleの構成比はそれぞれ30~40%、45~55%。うちペガトロンは、Appleの割合が過大として、近年は車載用、AIサーバーなどの新事業も展開。



(注) 生産割合とは、各社の当該スマホの生産量全体に占める当該地域の生産量の割合。

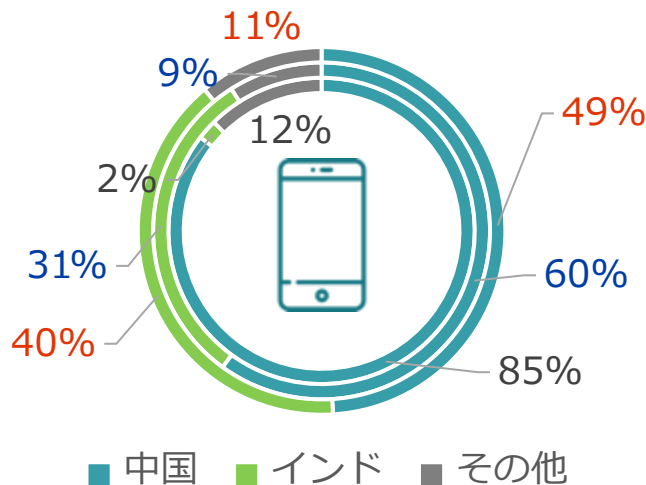
(出所) 各社資料、メディア、MIC整理、2026年1月

3-4 | 台湾スマートフォンODMの生産拠点の変化

インドにおける生産能力の拡大が加速

- 2026年末までに、Appleは**米国で販売するiPhoneの組立生産を全面的にインドに移転する方針**。
- ホンハイはインドにおける製造能力の拡大に向けて継続的に資本投入を強化。AppleもインドのTataグループへの支援を通じて、インドへの投資を実施。
- インドは独自のサプライチェーン構築を積極的に進めている。Tataグループは筐体加工や組立能力を発展させ、HindalcoはiPhone筐体製造などに使用されるアルミニウム供給メーカーとして参入。

台湾スマートフォン産業の生産拠点割合の変化



(注) 内側円から外側円へ：2019年、2025年、2029年（予測）
 (出所) 各社資料、メディア、MIC整理、2026年1月

台湾スマートフォンODMに関わる主な動向

- 2020年7月、ウィストロンは中国江蘇省の昆山工場を中国の立訊精密（ラックスシェア）に売却。
- 2023年8月、ウィストロンはインドでのiPhone組立を終了。カルナータカ州の工場をインドのタタグループに売却。
- 2023年12月、ペガトロンは中国の世碩昆山工場をラックスシェアの子会社である立臻に売却。
- 2025年1月、インドのタタグループは、ペガトロンのインド子会社の株式60%取得を発表。



- 2023年、Googleがインド製pixelの計画を立ち上げ、コンパルとインドOEMのDixonが提携して組立。



3-5 | スマートフォン産業における台湾企業と日本企業の強み

台湾企業：ハイエンド部品の供給、IC設計およびシステム統合（ODM/EMS）

- 中国企業や韓国企業にみられる完成品を中心とした垂直統合型の製造モデルとは異なり、台湾企業は分業化されたサプライチェーンの中で特定分野に特化。
 - ➔ チップ設計（聯発科（メディアテックなど））
 - 受動部品・光学/センサー部品（大立光、玉晶光など）
 - ICパッケージング・テストおよびウエハー製造（TSMCなど）
 - EMS/ODM（ホンハイ、ペガトロンなど）。

日本企業：重要技術およびハイエンド部品のサポーター

- 世界のスマートフォン産業のバリューチェーンにおいては、日本企業は川上の主要コンポーネント、材料・プロセス・精密製造、イメージング・受動部品・電池およびセンサー技術に強みを有する。

強み

台湾企業

弱み

高付加価値のバリューチェーン（設計、先進封止・テスト、先進製造プロセス）上で価格交渉力を有する。

大規模な組立製造は、多額の資本投資を要することに加え、地政学的リスクの影響を受けやすく事業展開上の制約に直面している。

強み

日本企業

弱み

日本は主要な中核部品分野において世界トップレベルの技術力を有しており、品質、信頼性、長期安定供給を高度に重視。

製品開発・投入のスピード感および市場への迅速な対応力に欠けるほか、コスト構造が高く、価格競争には不向きとの指摘も。

3-6 | モジュール分野、先端封止、自動化で日台協力の可能性

- 日本は精密材料や光学レンズコーティング、先端封止材料、テスト設備および機械自動化に優位性を有し、台湾はIC設計や先端封止・テスト、システムソリューションの統合に強みを持つ。
- 日台協力の可能性がある分野としてはモジュール分野、先端封止、自動化などが考えられる。

日台協力の可能性が高いと思われる分野

モジュール/部品

ハイエンドカメラモジュールおよび光学部品を共同で研究開発。
例：日本の材料と台湾のレンズモジュールシステムの統合など。

先端封止/ 放熱ソリューション

TSMCなどの封止・テスト工場と日本の材料や設備サプライヤーによるスマートフォン向け高計算能力SoCのパッケージングの共同開発など。

サプライチェーンの 製造自動化

日本企業が設備を輸出、台湾EMS/ODMが統合・導入することにより、ベトナム、インドなどの地域における生産の品質レベルの向上を図るなど。

(出所) 各社資料、MIC整理、2026年1月

3-7 | 台湾EMSの投資動向

- 台湾のスマートフォンデバイス製造業は引き続き中国から**インドや東南アジアへと分散**している。

地域	EMS	主な投資動向
インド	ホンハイ	<ul style="list-style-type: none"> ・ インドのカルナータカ州の工場を拡張、投資額は約26億2,000万ドル。 ・ 2025年Q2、インドのHCLグループと共同出資で新半導体工場を建設する計画を発表。総投資額は約131億台湾元、スマートフォン、車載機器、PC向けのディスプレイドライバICを生産予定。2027年に稼働開始。
	ペガトロン	<ul style="list-style-type: none"> ・ インドのタタと共同でiPhoneの組立を担う合併会社を設立することを決定。出資比率はタタが60%となる ・ 2025年Q2、インドの子会社PEGATRON ELECTRONICS INDIAに対し、約5億7,900万台湾元の増資を実施。初期段階ではネットワーク機器関連の事業を中心に展開する計画。
	コンパル	<ul style="list-style-type: none"> ・ インドのDixonと協力し、ノイダでGoogle Pixelのハイエンドモデルを生産する。将来的には毎月10万台のGoogle Pixelを生産する見込み。
ベトナム	ホンハイ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2024年Q2、北部バクザン省の新工場を建設するために1億1,961万ドルを投資。2025年Q2初めに生産開始し、かつ13億7,000台湾元をベトナム子会社Fushan Technologyに投資。5億5,100万ドルをクアンニン省の2件の工場新設に投資、2027年の量産開始を予定。 ・ ベトナム子会社Fushan Technologyはすでにバクザン省で大規模な増産計画を展開しており、スマートフォンの年間生産能力を1億4,000万台の水準に引き上げる計画。
	コンパル	<ul style="list-style-type: none"> ・ タイビン省リエンハータイ工業団地に第3工場を建設中。生産開始予定は2026年、投資額は約2億6,000万ドル。

(出所) 各社資料、メディア、MIC整理、2026年1月

Ⅲ. まとめ

まとめ

- **サーバー**：AIサーバーの演算性能を巡る競争の軸は、単一GPUの性能比較から、システム全体の最適化へと移行している。これにより、ラック単位での消費電力の急増しており、電源供給や冷却技術が運用面での主なボトルネックとなりつつある。サプライチェーンについては、台湾では高度な研究開発機能を維持しつつ、部品生産はコスト競争力の高いタイ、ベトナム、マレーシアなどに分散配置することで、地政学・事業リスクの切り分けを進めている。**米国でのサーバー製造は主に後工程の組立（L10/L11）が中心で、メキシコは北米市場向けのサーバー関連部品の供給拠点として存在感を高めている。**
- **ノートPC**：2026年のノートPC市場は「高関税・高コスト」の二重の圧力に直面している。メモリおよびストレージデバイスの需給ひっ迫により、PCの製造コストが上昇しており、一部モデルでは販売価格の上昇幅が16～30%に達する見通し。加えて、米中間の貿易摩擦および技術覇権争いの中、**対米輸出向けで製造拠点分散（チャイナプラスワン）と中国・その他新興市場向けで「CTE」活用の二極化が進んでいる。**
- **スマートフォン**：スマートフォン産業は「生産能力の脱中国化」を巡る重要な転換期を迎えている。台湾企業は米国系顧客とともに**インドでの生産能力を25%以上に引き上げ、2026年には対米輸出のiPhoneの全量を非中国製とすることを目指している。**一方、メモリ価格の高騰が収益を圧迫する中、**スマートフォンブランド各社は規模拡大路線から収益安定を重視する戦略へと軸足を移しつつある。**具体的には、「ダウンスケール（メモリ搭載量の引き下げ）」または「端末価格の引き上げ」を主なリスク回避策として採用する動きが広がっている。

レポートをご覧いただいた後、 アンケートにご協力ください。

(所要時間：約1分)

<https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20260003>



レポートに関するお問い合わせ先

日本貿易振興機構（ジェトロ）

調査部中国北アジア課



03-3582-5181



ORG@jetro.go.jp



〒107-6006

東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

■ 免責条項

本レポートは、日本台湾交流協会の協力を得て、財団法人資訊工業策進会産業情報研究所（MIC）に委託して作成しました（2026年1月時点）。本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

禁無断転載